

柏騰科技 (3518)

法人說明會

日期：2024 / 8 / 26

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容，未來若有任何變更或調整，本公司不負責更新或修正。

大綱

CONTENTS

01

公司簡介 Company Overview

02

財務資訊 Financial Information

03

SiC新廠進度報告
progress report For advanced SiC factory

04

資訊交流 Q&A



公司簡介



柏騰科技(3518)

柏騰科技（台灣證券交易所 | 股票代號3518）成立1995年，為全球首家將真空濺鍍薄膜技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案，也為台灣證券交易所首家真空濺鍍技術公司。

- 
- ◆ 成立時間：84.10.20
 - ◆ 資本額：96,042萬元
 - ◆ 董事長：黃逸駿
 - ◆ 總經理：游秀屏
 - ◆ 目前主要產品及其應用：
PVD鍍膜－佔比 95%
其他－佔比 5%

關於柏騰



柏騰臺灣總部 技術開發

- 成立時間：1995年
- 資本額：9億6仟萬



EMI電磁波防護鍍膜& 外觀鍍膜產品

- 蘇州廠/南京廠/內江廠 (PVD鍍膜&設備)
- 全球NB品牌，塑膠機殼EMI供應商龍頭
- 市占率50%，出貨約5,000萬件/年



碳化矽(SiC)晶圓

- 南崁廠(2023.1)
- 嘉義廠(建置中)
- 6~8吋碳化矽(SiC)晶圓

發展歷程

柏騰為全球首家將真空濺鍍薄膜技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案，目前為NB防EMI最大供應商，市佔率約50%，為業界少數具備EMI製造、PVD設備及製程設計能力。2022年併購晶成材料擁有SiC(碳化矽)基板生產技術並進入第三代半導體供應鏈，2023年董事會決議建置SiC 8吋基板廠。





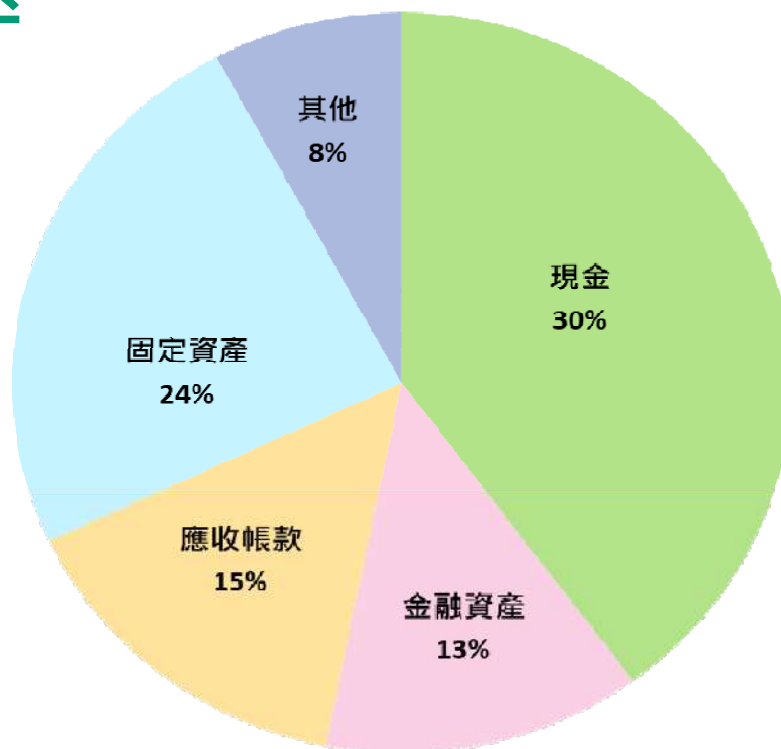
財務資訊

2024年第二季合併資產負債表

單位:新台幣佰萬元

	2024.6.30	%	2023.12.31	%	2023.06.30	%
現金及約當現金	684	40	801	51	596	34
金融資產-流動&非流動	226	13	58	4	472	27
應收帳款及票據	255	15	279	18	263	15
存貨	19	1	22	1	4	0
待出售非流動資產	23	1	25	2	23	1
固定資產及使用權資產	413	25	314	20	314	18
其他動資產	94	5	63	4	101	5
資產總計	1,713	100	1,561	100	1,773	100
短期及一年內到期借款	230	13	194	12	124	7
其他應付款	69	4	72	5	132	7
長期借款	46	3	5	0	7	0
其他負債	202	12	64	4	82	5
負債總計	548	32	336	21	344	19
權益總計	1,165	68	1,226	79	1,429	81
每股淨值	13.86		14.59		17.70	

財務結構與比率



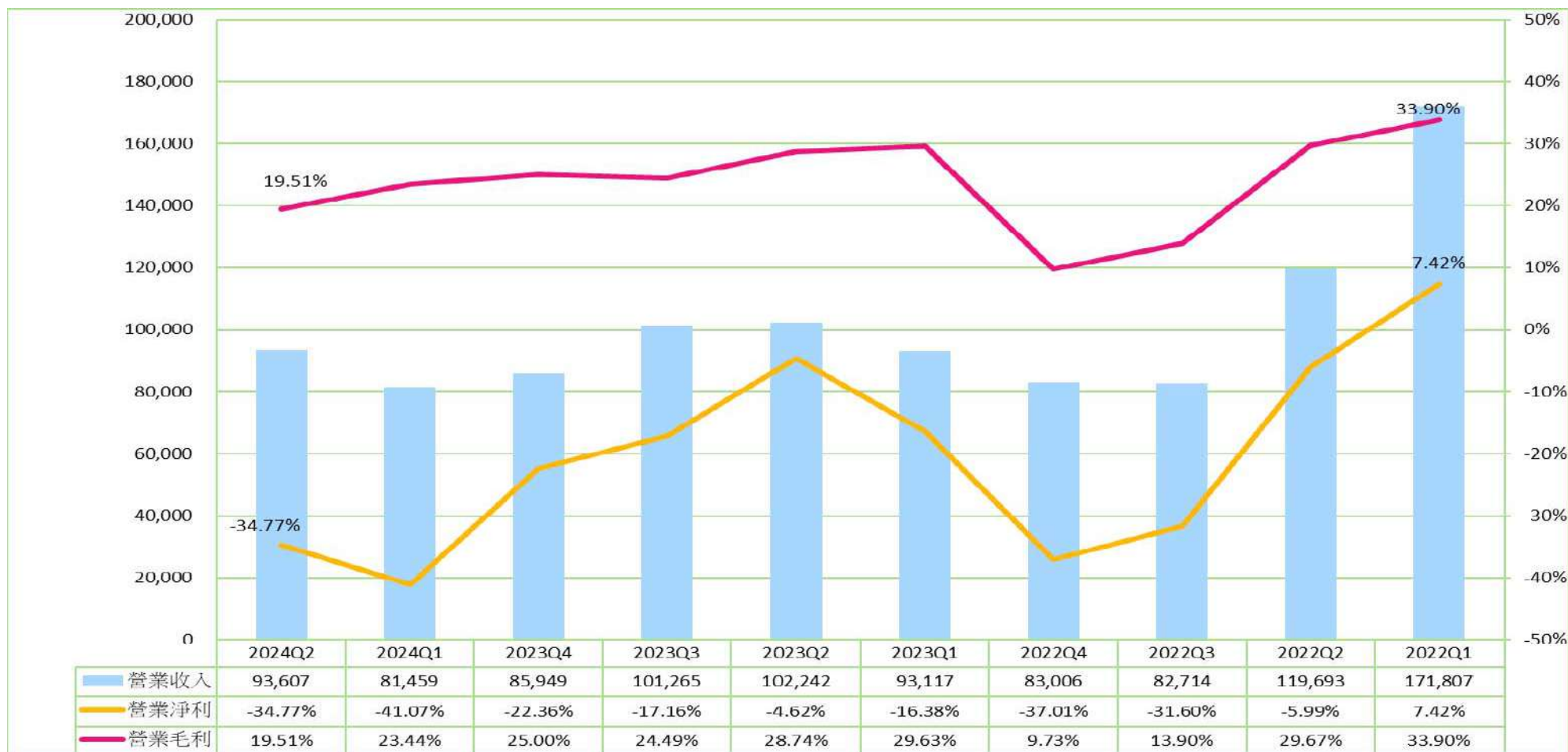
項 目	2024年Q2	2023年	2022年	2021年	2020年
負債比率	31.97	21.49	16.30	24.54	37.12
流動比率	345.58	395.27	606.50	377.86	185.25
現金流量比率	(4.44)	(17.17)	63.32	31.54	(1.05)

2024年第二季合併綜合損益表

單位:新台幣佰萬元

項目	2024年第二季	2024年第一季	增減%	2023年第二季	增減%
營業收入	94	81	15	102	(8)
營業毛利	18	19	(4)	29	(36)
營業費用	51	53	(3)	33	53
營業淨利(損)	(33)	(33)	3	(5)	(589)
營業外收支	3	7	(55)	2	32
稅前淨利	(30)	(27)	(10)	(2)	(1103)
所得稅費用	16	20	(20)	1	(1361)
本期淨利	(46)	(47)	(3)	(1)	(3756)
毛利率(%)	20	23		28	
純益率(%)	(49)	(58)		(1)	
每股盈餘(元)	(0.55)	(0.57)		0.00	

收入與毛利率趨勢圖



2024年第二季合併現金流量表

單位:新台幣佰萬元

	2024年1月1日 至6月30日	2023年1月1日 至6月30日
營業活動之淨現金流入(出)	(16)	6
投資活動之淨現金流入(出)	(216)	(307)
籌資活動之淨現金流入(出)	93	40
匯率變動對現金及約當現金之影響	22	(29)
本期現金及約當現金增(減)數	(117)	(290)
期初現金及約當現金餘額	801	886
期末現金及約當現金餘額	\$684	\$596

近期重要事件說明

- ◆ 113年國內第一次有擔保可轉換公司債收足債款。(113.8.13)
- ◆ 董事會通過現金增資子公司晶成材料新台幣6億元。(113.8.09)
- ◆ 通過子公司晶成SiC新廠生產設備採購新台幣2.7億元。(113.8.09)
- ◆ 董事會通過真除游秀屏小姐代理總經理職位，正式任命為總經理。(113.8.09)
- ◆ 113年現金增資收足股款暨增資基準日。(113.7.10)
- ◆ 股東常會改選7席董事，董事會一致推舉黃逸駿先生擔任董事長。(113.6.18)
- ◆ 董事會通過辦理113年現金增資及發行113年國內第一次有擔保可轉換公司債(113.3.13)
- ◆ 本公司登記地址遷至「桃園市蘆竹區南山路一段108巷2號」(113.01.25)
- ◆ 通過子公司晶成SiC新廠生產設備採購新台幣1.6億元。(113.01.25)

詳情請參閱柏騰公司網站 (<https://www.pttech.com.tw>) 最新消息公告及公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>) 重大訊息公告。



SiC 新廠進度報告

progress report For advanced SiC factory

SiC新廠投資計劃

- ◆ 建廠預算：新台幣 89,953 萬元(一期)
- ◆ 新廠位置：嘉義大埔美智慧型工業園區
- ◆ 主要產品：8吋SiC晶圓
- ◆ 一期產能：3000PCS/月 / 50 台長晶爐
- ◆ 最大產能：6000pcs/月/100 台長晶爐

2024H2 (建置期)

ISO9001及14001認證
通過目標客戶認證
開始建置新廠廠務及工程
導入先進8吋長晶製程設備，縮短製程開發時間

2025 (新廠啟用)

Q1廠務工程完工驗收
Q2設備move in完成
Q3設備試量產準備
Q4新廠正式啟動
開發非車用產品
年產能4000pcs

2026 (一階段)

ISO16949認證
通過目標車用客戶認證
年產能24000pcs
歐美目標客戶送樣
開發高階功率產品

2027 (二階段)

通過歐美車用大廠認證
進入品牌車廠供應鏈
年產能36000pcs
進行新廠二期擴產準備
最大年產能72000PCS

競爭優勢

發展高價值的利基產品

目前8吋SiC量產的廠家仍為少數，目前市場供不應求，未來將成為市場主流產品。

完整的供應鏈經驗

晶成團隊擁有SiC長晶、晶圓加工、磊晶及化合物半導體生產銷售研發供應錄關係良好，可以儘快進入市場。



低成本的高獲利能力

具備較低成本的競爭優勢，可較同業更早達到獲利。

導入8吋先進量產製程

直接導入8吋量產製程設備，縮短學習成本及低設備投入成本。

低成本的競爭力

自製晶種、自主開發特殊關鍵耗材、熟悉脆硬材料加工技術。

完整製程縮短開發時程

基板全工段製程較同業擁有時效性及品質能力，縮短技術開發時間。



資訊交流

Q&A

TRUE PARTNER FOR A BRIGHTER FUTURE



發言人：劉明怡 財務處副總

電話：(03)212-8833

E-mail：mingi@pttech.com.tw.